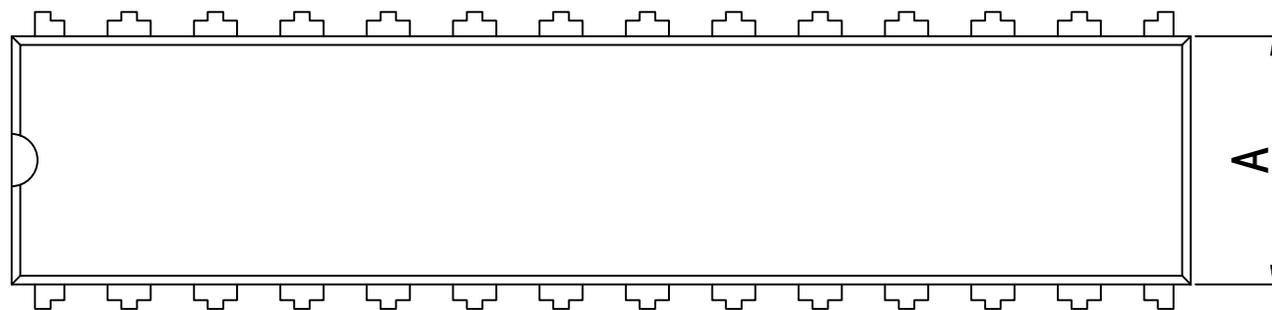
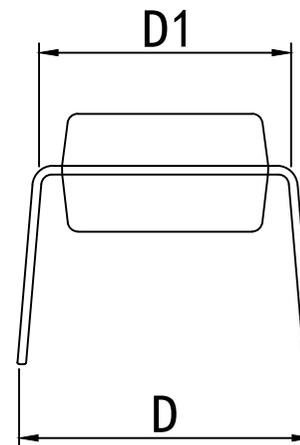
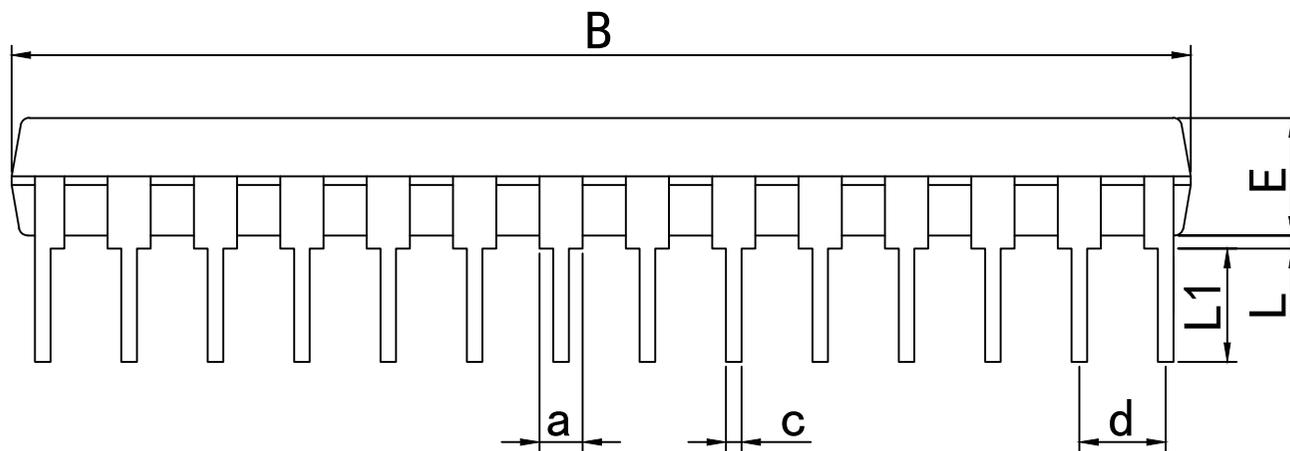




华冠半导体

广东华冠半导体有限公司
Guangdong Huaguan Semiconductor Co., Ltd.



制图	赖谊成
审阅	罗云龙
核准	林钟涛

DIP28

文件名称:
HG-DIP28

文件编号:
HGWXT-2300063

版本	VI.0
比例	1:1
单位	mm
日期	2023-7-19

图纸幅面 A4



第一角法

UNITT: mm

DIM.	A	B	D	D1	E	L1	a	c	L	d		
MIN	6.99	34.16	8.13	7.62	3.18	3.18	1.02	0.41	0.38	2.54		
MAX	7.49	35.18	10.92	8.26	3.43	3.43	1.65	0.56	BSC	BSC		